

华泰联合证券有限责任公司
关于江苏先锋精密科技股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
之

上市保荐书

保荐人（主承销商）



（深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401）

目 录

目 录.....	1
一、发行人基本情况	2
二、申请上市股票的发行情况	16
三、保荐人工作人员及其保荐业务执业情况.....	17
四、保荐人及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往来情况说明.....	18
五、保荐人承诺事项	18
六、保荐人关于发行人是否已就本次证券发行上市履行了《公司法》《证券法》和中国证监会及上海证券交易所规定的决策程序的说明.....	19
七、保荐机构针对发行人是否符合板块定位及国家产业政策的依据及核查情况	19
八、保荐人关于发行人是否符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的上市条件的说明	25
九、保荐人关于发行人证券上市后持续督导工作的具体安排.....	31
十、其他说明事项	32
十一、保荐人对发行人本次股票上市的保荐结论.....	32

华泰联合证券有限责任公司关于 江苏先锋精密科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市之上市保荐书

上海证券交易所：

作为江苏先锋精密科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人，华泰联合证券有限责任公司及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）及贵所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

现将有关情况报告如下：

一、发行人基本情况

（一）发行人概况

发行人名称：江苏先锋精密科技股份有限公司

注册地址：江苏省靖江市经济开发区新港大道 195 号

成立日期：2008 年 3 月 20 日

注册资本：15,178.4856 万元

法定代表人：游利

联系方式：0523-85110266

经营范围：许可项目：技术进出口；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；机械零件、零部件加工；机械零件、

零部件销售；专用设备修理；模具制造；模具销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（二）发行人的主营业务、核心技术和研发水平

1、发行人的主营业务

公司是国内半导体刻蚀和薄膜沉积设备细分领域关键零部件的精密制造专家，尤其在国际公认的技术难度仅次于光刻设备的刻蚀设备领域，公司是国内少数已量产供应 7nm 及以下国产刻蚀设备关键零部件的供应商，直接与国际厂商竞争。在聚焦半导体领域的同时，公司充分发挥精密零部件技术的扎实基础及创新能力优势，积极在光伏、医疗等其他领域探索和开发新产品。经过逾 15 年的技术积累和产品工艺自主研发，公司建立了精密机械制造技术、表面处理技术、焊接技术、高端器件的设计及开发技术和定制化工装开发技术等五大核心技术平台，在日趋严苛的应用条件下，通过生产实践不断实现工艺能力的迭代进化，持续满足先进装备更新迭代的工艺需求，致力于成为全球有竞争力的精密制造企业。

在掌握的核心技术平台基础上，公司紧贴客户需求，将跨学科知识、多实验工艺方法、多方产业链资源加以整合，形成了关键工艺部件、工艺部件和结构部件三大类主要产品，重点应用于刻蚀设备和薄膜沉积设备等半导体核心设备中。在刻蚀领域，公司主要提供以反应腔室、内衬为主的系列核心配套件；在薄膜沉积领域，公司主要提供加热器、匀气盘等核心零部件及配套产品。

零部件是半导体设备国产化的重要载体，公司凭借产品专精的特点在国内本土半导体设备厂商国产化浪潮中占据重要地位，并在刻蚀和薄膜沉积设备的关键零部件上实现了国产化的自主可控。公司自设立时起即与中国装备龙头企业北方华创和中微公司开展密切合作，作为核心零部件的重要供应商协助客户诸多设备经历了研发、定型、量产和迭代至先进制程的完整历程。除北方华创和中微公司外，公司还与拓荆科技、华海清科、中芯国际、屹唐股份等其他行业头部设备客户和终端晶圆制造客户建立了长期稳定的战略合作关系。未来，公司将充分利用国产化浪潮机会，继续坚持面向经济主战场、面向国家重大需求、优先服务国内本土半导体设备企业的战略方针，深耕半导体产业链“卡脖子”领域，筑牢国产半导体设备供应链安全基础，积极推动国内大循环。

公司产品为各类精密金属零部件，具有“小批量、多批次、定制化”的特点，不同产品的种类、大小、材质、性能指标差异较大，细分品号众多，核心产品主要为腔体、内衬、加热器和匀气盘等关键工艺部件及各类工艺部件。

报告期内，公司各大类产品主营业务收入构成如下：

单位：万元，%

产品类别	2024年1-3月		2023年度		2022年度		2021年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
关键工艺部件	8,617.82	40.18	23,412.58	42.57	22,082.48	47.65	19,464.38	46.43
工艺部件	6,484.49	30.24	13,667.23	24.85	14,766.45	31.86	12,127.69	28.93
小计	15,102.32	70.42	37,079.81	67.41	36,848.93	79.51	31,592.07	75.36
结构部件	4,474.06	20.86	9,631.65	17.51	8,148.98	17.58	5,937.67	14.16
半导体设备零 部件小计	19,576.38	91.28	46,711.46	84.93	44,997.92	97.09	37,529.74	89.52
其他	1,869.33	8.72	8,291.47	15.07	1,348.64	2.91	4,392.70	10.48
合计	21,445.71	100.00	55,002.93	100.00	46,346.55	100.00	41,922.44	100.00

注：其他主要为光伏、医疗装备零部件、模组及少量表面处理服务

2、发行人的核心技术

经过多年积累，公司具备了金属零部件精密机械制造技术、表面处理技术、焊接技术、高端器件的设计及开发技术、定制化工装开发技术等多项技术体系，能够根据产品的不同使用环境需求搭配出最高效的材料方案和工艺实现路径。公司主要依托精密机械制造技术、焊接技术进行高精度机械制造，对于需要表面处理技术的产品，公司能够通过自身积累的硬质阳极氧化技术、增强型阳极氧化技术、高性能化学镀镍技术和高洁净度精密清洗技术，满足客户对产品严苛的耐腐蚀性要求。

公司在生产过程中，出于不断优化和改进工艺流程、主要工艺技术节点的需要，推动了各生产要素技术的进步和积累，形成了较为丰富的 know-how。除上述三大工艺技术外，公司还会根据各类零部件材质、工艺、形状、性能的不同定制化设计工装，配合生产设备以高效适配各类零部件生产。因此，在工装定制化设计方面，公司具备深厚的技术积累，形成了定制化工装开发技术。

通过上述核心制造技术，公司不仅能够根据客户需求向客户交付各类定制化产品，还在长期陪伴国内龙头企业的产品更新及技术发展过程中形成了部分产品

的创新与突破，以此形成了高端器件的设计及开发技术，并不断迭代。特别在加热器领域，通过自研核心技术成功进入国内半导体设备龙头企业。公司核心技术均已处于大批量生产阶段，广泛应用于各类零部件的研发及制造中，具体如下：

(1) 精密机械制造技术

发行人经过多年的制造经验积累和新产品开发经验，针对复杂多样的产品特性，形成了应对多种复杂零件的精密制造技术、高平面度和粗糙度控制制造技术、高精度微小孔制造技术等精密机械制造技术，能够满足半导体设备制程不断迭代演进的技术需求，实现对多种类金属复杂腔体、复杂多面体零部件的超精细切削制造和高精度控制。

核心技术名称	主要应用产品	代表性专利	技术来源	具体特征
复杂零件精密制造技术	腔体、内衬等各类金属零部件，应用于刻蚀、薄膜沉积设备等	一种用于刻蚀机的具有冷却结构的内衬及其加工方法	自主研发	1、多种类铝合金和不锈钢复杂腔体加工：可加工复杂曲面和复杂结构的各类腔室，反应腔最大尺寸可达 2400x2400x300 毫米，传输腔最大尺寸可达 3200x1800x420 毫米，单件几何尺寸达 500 以上； 2、柔性制造技术：实现复杂多面体零部件的连续加工； 3、高精度控制：加工过程中进行实时测量，确保尺寸； 4、密封面粗糙度加工控制：通过严格的工艺和过程控制，保证了密封面的精度和粗糙度，安装后，保证设备的超高真空密封要求
高平面度和粗糙度控制制造技术	腔体、内衬、匀气盘、真空吸盘、静电卡盘等各类金属零部件，应用于刻蚀设备	一种不锈钢电解管磨粒流工装	自主研发	多种铝合金和不锈钢半导体零部件表面高精密零件加工：通过切削优化与精密研磨技术，平面度平行度小于等于 2 微米；粗糙度控制在 Ra0.02 微米以内
高均匀性晶圆加热器制造技术	详见本节之“（4）高端器件的设计及开发技术”			
高精度微小孔制造技术	匀气盘，应用于刻蚀、薄膜沉积设备等	一种镀膜气体分配法兰气体分配孔加工装置	自主研发	1、微小孔加工：可加工最小孔径为 0.15 毫米小孔； 2、微小深孔加工：可以加工孔深度与孔直径比为 25 倍的微小深孔； 3、多孔高精度加工：数千到上万个微小孔的孔径标准差最低可达 0.25 微米； 4、微孔内壁粗糙度：Ra0.4 微米以内

核心技术名称	主要应用产品	代表性专利	技术来源	具体特征
超精密测量技术	对超精密特征零部件进行准确的检测	一种半导体去胶设备的异形密封区域检验工装及检验方法	自主研发	1、超微特征的尺寸精度以及特征都超过了三坐标的检测范围； 2、选用微米级测量仪器配合自研工装夹具实现对超微特征以及超精尺寸测量，保证零件的尺寸精度； 3、分辨率在 0.1-10 微米之间，测量范围最大可达 1 米

(2) 表面处理技术

发行人通过综合运用阳极氧化、化学镀镍和高洁净度清洗等多项表面处理工艺，赋予了半导体零部件超高洁净度、超强耐腐蚀能力、高抗裂性等特殊能力，大幅提高了产品的使用寿命和性能。

核心技术名称	主要应用	代表性专利	技术来源	具体特征
高致密硬质阳极氧化技术	刻蚀设备中的腔体、加热器、匀气盘、内衬等	一种多盲孔、深孔铝制零件阳极氧化设备、一种胶印机铝合金滚筒的硬质阳极氧化挂具	自主研发	1、应用于刻蚀设备中高腐蚀性工作环境，为接触到刻蚀介质的关键部件提供有效保护，隔离杂质元素对晶圆反应环境的渗透污染； 2、耐腐蚀：经过高致密硬质阳极氧化技术处理后的产品，在 5%浓度盐酸浸泡实验中，可取得 400 分钟无气泡产生
增强型阳极氧化技术	特殊刻蚀设备中的高温和强腐蚀环境中的腔体、加热器、匀气盘、内衬等，应用于刻蚀、薄膜沉积设备等		自主研发	1、抗裂性：在大于 100 摄氏度的环境中，无可视裂纹，具有优良的抗裂性； 2、耐腐蚀：经过增强型阳极氧化技术处理后的产品，在 5%浓度盐酸气泡实验中，可取得 600 分钟无气泡产生
高洁净度精密清洗技术	加热器、内衬、传输腔、匀气盘等，应用于刻蚀、薄膜沉积设备等	一种用于刻蚀机气体分配器清洗装置	自主研发	经过高洁净度精密清洗技术处理后的零部件，可达到： 1、QⅢ颗粒度：按照零件表面积换算的每平方厘米含有直径大于0.2微米的粒子数量<5； 2、LPC 液粒计数：按照零件表面积换算的每平方厘米含有直径大于 0.2 微米的粒子数量≤100000； 3、ICP-ms 微量金属残留：按照零件表面积换算的每平方厘米含有的 13 种微量金属杂质数量少于标准数量
高性能超高磷镀镍工艺	薄膜沉积先进制程用设备工艺部件	-	自主研发	1、采用流体涡旋镀膜工艺实现复杂结构、超大面积工件无表面缺陷； 2、镀层磷含量在 12%-16%之间； 3、盐雾测试 24 小时后镀层不能出现基体腐蚀现象；

核心技术名称	主要应用	代表性专利	技术来源	具体特征
				4、浓硝酸溶液中完全浸泡大于 30 秒，洗净后镀层无变色

(3) 焊接技术

发行人为达到对复合结构精密件的导热性、密封性、洁净度等特定性能要求，需要半导体设备零部件制造商充分评估产品材料性能及功能要求，对焊接材料、焊接工艺、焊接参数等进行研究，持续满足不断迭代的半导体设备工艺制程的严苛要求。

核心技术名称	主要应用产品	代表性专利	技术来源	具体特征
FSW 搅拌摩擦焊接技术	加热器、内衬、传输腔等，应用于刻蚀、PECVD 和 PVD 设备等	一种带磁铁环的直冷阴极衬套的焊接工艺	自主研发	<ol style="list-style-type: none"> 1、将摩擦焊工艺引入带磁环阴极内衬制造，通过对零件工艺和结构的改良，解决了传统焊接工艺中的过热导致的磁性失效； 2、通过对摩擦焊的精准控制，极大提高了焊缝质量，使得内衬在高腐蚀环境下的使用寿命提高三倍以上
机器人自动焊接技术	冷却环，应用于刻蚀、PVD 设备等	一种高效储存腔体焊接变位机	自主研发	<ol style="list-style-type: none"> 1、具备稳定的焊接质量，一致性高，可精确定位控制焊接轨迹，有效克服手工焊接一致性差的问题； 2、解决传统手工大批量加工受人为因素影响焊熔深不稳定的问题，焊接质量达到国内半导体设备龙头企业标准
真空钎焊技术	加热器、内衬和水冷板等，应用于刻蚀、PECVD 和 PVD 设备等	一种新型水冷盘及其焊接工艺	自主研发	<ol style="list-style-type: none"> 1、将真空钎焊技术应用在具有复杂构造的晶圆加热器生产中，实现多达 5 层结构的结合面熔合，满足加热器严苛温均性要求下的高效热传导； 2、可实现大截面产品的焊接要求，在复杂结构匀气盘制造中采用真空钎焊技术，最大直径可达 900mm； 3、通过精准控制焊料，可解决薄壁复杂流道结构的焊接，实现流道畅通无堵塞
真空电子束焊接技术	加热器、匀气盘等工艺部件	-	自主研发	<ol style="list-style-type: none"> 1、更高的深宽比，且无需焊接坡口，深宽比最大可达 50:1； 2、热输入非常少，所以只有非常小的焊接变形，直径 300mm 特征焊接，变形量可以控制在 0.05mm 以内； 3、热输入小，接头及影响区性能接头性能更高可达母材的 80%； 4、配合先锋柔性制造技术以及定制化工装开发技术，焊接自动化程度以及焊接一致性上更高，目前已经实现焊接过程完全自动化

(4) 高端器件的设计及开发技术

从全球范围看，半导体设备内使用的高端器件市场主要为国外厂商所垄断，其中加热器是半导体设备零部件中技术难度较高、工艺制造较为复杂且具备完整功能的高端器件之一。经过多年自主研发，公司是国内少数已实现量产金属晶圆加热器的供应商，并成为国内龙头半导体装备企业的战略合作伙伴。

基于晶圆先进制程中对加热器多样性、高功效、高温均性、高洁净等的严苛要求，发行人需要针对性结构设计，将经过特殊设计的发热元件与载台匹配组合，通过热场设计、仿真模拟和功能实验等技术手段，使得发热元件性能和晶圆接触结构精确匹配，实现半导体制程中的精准温控，并满足半导体产品工艺效益和持续可靠性。

核心技术名称	主要应用产品	代表性专利	技术来源	具体特征
均匀温场设计技术	加热器,应用于刻蚀、薄膜沉积设备等	一种晶圆加热器表面温度分布检测装置	自主研发	1、可根据客户不同应用场景，进行多种加热器的整体设计； 2、根据使用工况，进行力学、加热器功率计算、温度分布仿真，确保结构稳定、温度分布最优； 3、使用特殊设计的快速样件进行温度测试，确保温度分布符合客户需求； 4、各种应用环境产品的设计加工；积累了 300 余种型号的各类晶圆加热器的研发设计经验
热损控制技术		一种用于半导体设备的加热器	自主研发	1、可通过隔热设计，引入合适的金属隔热层，以低成本降低热量损失，确保晶圆加热器表面温度均匀性； 2、使用特殊热喷涂技术，在易导热界面上形成陶瓷隔热层，可大幅提升密封圈的使用寿命和晶圆加热器的表面温度均匀性； 3、通过多区温度补偿技术，通过控制功率输出百分比，减少因腔体内部结构导致的局部热量损失过大的问题，实现一款加热器可使用于多种不同尺寸的真空腔体内
协同控温技术		一种可大幅度调节冷却能力的晶圆加热器	自主研发	1、可通过特殊冷却结构设计，使得在 500°C 高温运行时也可进行水冷和气冷，抵消工艺产生的大量热量对温度控制的影响，确保控温准确； 2、通过设计内置的全贴合冷却部件，加热管加热、冷却部件同时通冷却液，可以在 < 100°C 低温工况时获得更精准的温度均匀性

核心技术名称	主要应用产品	代表性专利	技术来源	具体特征
高均匀性晶圆加热器制造技术		一种具有双温控制功能的加热器的加工方法、降低晶圆离子污染的高均匀性晶圆加热器	自主研发	1、可通过特殊的表面粗糙度制造技术，减少金属盘面与晶圆的接触面积，大幅减少金属离子污染； 2、可通过精密加工，在晶圆加热器表面加工数百个微型凸台，与晶圆的接触面积降至 1%； 3、通过定制化精密抛光工艺，控制表面平面度 $\leq 2.5\mu\text{m}$ ，粗糙度 $< \text{Ra}0.025$ ，减少颗粒吸附； 4、在工作温度的温度均匀性可以保证 $\leq \pm 0.8\%$ ； 5、产品正常使用寿命可以 $\geq 30,000$ 小时
核心部件性能升级技术		一种用于真空环境的小直径加热装置	自主研发	1、可通过流道、冷却管路、增加辅助加热等的结构设计，大幅提升机台的冷却和升温速度，可以缩短 2/3 的冷却时间，提升工艺效率； 2、通过升级局部辅热装置，消除原有的冷点，提升整体的加热效率，可将晶圆达到热平衡所需的时间缩短至原来的 50%，温度均匀性提升至 $\pm 0.5\%$ ，提升工艺效率； 3、通过对零部件表面形貌、电极等的优化设计，减少卡盘类零件被等离子体击穿的风险，使用寿命可以提升 2 倍以上
晶圆检测模组和真空腔体模组设计组装技术		一种半导体腔体盖板升降机构	自主研发	1、模块化设计：允许灵活配置和升级，内部集成快速调温装置，以兼容 6、8、12 及更大尺寸的晶圆加热器； 2、集成温度控制系统，以控制腔体内的温度，可搭载自动化控制系统，集成高效真空泵和精密控制阀门，用于抽气和气体流量控制，气体流量控制兼容从 0-6000SCCM 的气体流量需求，测试模组腔体压力可以精准控制在 0.01mtorr-10torr

(5) 定制化工装开发技术

半导体设备金属零部件具有结构复杂、加工精度要求高、多品种、小批量的特点，加工制造过程对一致性和生产效率的要求极高。精密工装作为对零部件进行定位、夹持、锁紧的工具，其设计和使用会对产品的质量和生产效益产生较大影响。发行人通过长期研发积累了门式工装、动力工装、标准化和互换性工装等技术并应用于生产实践，高效完成客户的定制化复杂产品需求，以此使得生产制造方式不断优化、现有设备及生产效率持续提升，同时与先进加工管理流程进行

结合，实现了良好的成本与质量效益。

核心技术名称	主要应用产品	代表性专利	技术来源	先进性及具体表征
典型反应腔室高效生产工装技术	腔体，主要应用于刻蚀设备	一种快速膨胀定位装夹系统、一种用于大型工件的简易自锁紧吊装工装	自主研发	1、通过门式工装的设计，仅两次作业工序转换，就可以集成所有 CNC 精密作业任务，装夹次数减少 50%，降低多次定位精度偏差； 2、结合刀具及程序优化，使得加工时间降低 20%以上，实现腔体单机连续生产
动力装置设计及应用技术	腔体、法兰盘等，主要应用于刻蚀设备及光伏设备	一种高效半自动刷镍机、一种用于刻蚀机气体分配器清洗装置	自主研发	1、在精密加工中，通过运用动力工装，对 CNC 设备低效作用区和加工死区进行替代和补充作业，起到增加产能和提效降本作用； 2、在依赖传统手工作业的局部表处理工序中，通过动力装置实现人工替代，保障工艺稳定性，并提高生产效率； 3、在洁净工艺中，通过动力装置，在局部死角实现循环清洗
标准化和互换性工装技术	各类零部件	便于安装和调整角度的角度头工装、一种快速膨胀定位装夹系统、一种异形件打磨清洗用夹持工装、一种驱动座的开放孔抛光工装	自主研发	1、在各类设备以及工装设计中，将标准化技术应用于定位、锁紧和夹持等执行功能中，支持零件和工装在多工种、多类型设备间的快速和灵活转换； 2、通过互换性技术设计的同类零部件通用型工装，有效应对同类型多品种研发快速响应需求，显著提升新品开发能力

3、发行人的研发水平

公司的研发实力是其核心竞争力的重要来源。公司从设立之初就十分重视研发，在精密机械制造技术、表面处理技术、焊接技术、高端器件的设计及开发技术和定制化工装开发技术等方面持续投入。近年来公司业务进入高速增长阶段，研发需求持续增长，报告期各期，公司研发费用分别为 2,154.10 万元、3,097.44 万元、3,630.90 万元和 1,198.95 万元，2021-2023 年复合增长率为 29.83%，研发投入力度不断加强。

公司取得的科研成果已经形成公司的核心技术并充分产业化，服务于下游客户半导体设备生产制造。目前，公司产品已经批量应用于国内头部半导体设备制造商，并成为该等客户同类产品的重要供应商之一。例如，在中微公司批量生产的应用于 7nm 及以下制程芯片生产线的 CCP 刻蚀设备及其氮化镓基 LED MOCVD 设备领域，公司是关键工艺部件——腔体、匀气盘的核心供应商，在国内半导体刻蚀和薄膜沉积设备的核心金属零部件领域占据重要地位。

（三）发行人主要经营和财务数据及指标

项目	2024.3.31/ 2024年1-3月	2023.12.31/ 2023年度	2022.12.31/ 2022年度	2021.12.31/ 2021年度
资产总额（万元）	115,400.32	107,054.62	90,926.38	86,358.20
归属于母公司所有者权益（万元）	79,345.90	74,359.31	65,105.99	52,148.63
资产负债率（母公司）（%）	29.20	28.14	24.69	38.68
营业收入（万元）	21,646.61	55,771.69	46,971.82	42,364.79
净利润（万元）	4,678.48	8,027.50	10,479.03	10,518.74
归属于母公司所有者的净利润（万元）	4,678.48	8,027.50	10,479.03	10,518.74
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润（万元）	4,677.54	7,978.54	9,895.25	8,362.26
基本每股收益（元）	0.31	0.53	0.70	不适用
稀释每股收益（元）	0.31	0.53	0.70	不适用
加权平均净资产收益率（%）	6.09	11.55	17.92	42.28
经营活动产生的现金流量净额（万元）	1,097.08	13,607.40	5,430.41	1,246.17
现金分红（万元）	-	-	2,500.00	8,267.50
研发投入占营业收入的比例（%）	5.54	6.51	6.59	5.08

注：公司 2022 年 11 月股改前为有限公司，故不适用基本每股收益及稀释每股收益，下同

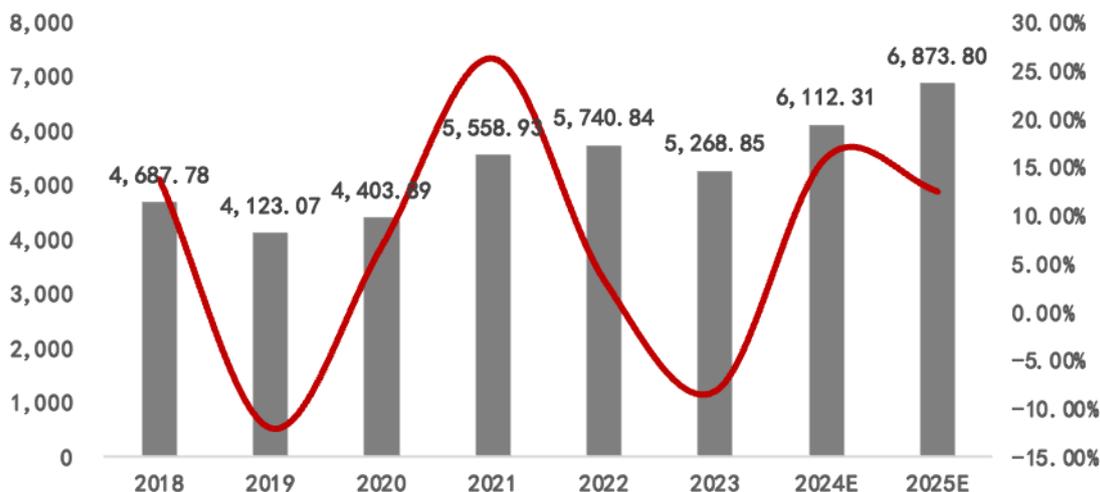
（四）发行人存在的主要风险

1、行业周期性风险

公司所处的半导体设备 精密零部件行业是半导体行业上游，半导体行业的整体发展情况会对公司所处行业产生较大影响。受扩产周期、创新周期等因素的叠加作用，半导体行业具有典型的周期性特点，通常每 4-5 年完成一轮周期波动，呈螺旋式上升的特点，其中 2-3 年处于上行通道，3-6 个季度处于下行通道。在经历了 2021-2022H1 的较快增长后，2022H2 由于下游消费电子需求疲软，产能紧张时期的供应链库存累积，全球半导体市场进入下行周期，该下行周期在 2023 年下半年起逐渐复苏。

根据 WSTS 预测，全球半导体市场在经历周期性低谷后，将于 2024 年重新进入上升周期，具体如下：

2018-2025年全球半导体行业市场规模（亿美元）



数据来源：WSTS

在行业处于周期性上行通道时，公司需要保持及提高产能来满足产业链下游客户快速提升的需求。若公司不能及时应对客户需求的快速增长，可能会导致公司失去既有或潜在客户；在行业处于周期性下行通道时，计算机、消费电子等终端消费需求下降，半导体设备厂商、晶圆厂面临产能过剩，继而削减资本性支出，对公司产品的需求亦可能下降。

虽然长期看，半导体行业作为电子信息产业的基石，人类社会智能化、数字化的大趋势将继续演进，半导体行业的长期需求将持续向好，但在行业处于周期性下行通道时，因晶圆制造企业、半导体设备企业削减资本性支出，公司新增订单可能出现下滑，进而影响公司的经营业绩。

2、业绩波动的风险

报告期内，公司的营业收入分别为 42,364.79 万元、46,971.82 万元、55,771.69 万元和 21,646.61 万元，2021-2023 年复合增长率为 14.74%，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为 8,362.26 万元、9,895.25 万元、7,978.54 万元和 4,677.54 万元。

2023 年度，发行人主营业务收入为 55,002.93 万元，同比上升 18.68%，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润同比下降 19.37%，主要原因系综合毛利率同比下降 9.23%，综合毛利率下降的两大主要原因系：（1）受半导体强周期性及外部科技封锁叠加影响，2023 年国内主要晶圆厂资本开支暂时减

少，由此导致直接客户对发行人的产品需求下降，发行人半导体领域产品产能利用率降低，毛利率下降；（2）光伏领域产品占比上升，而其毛利率相对较低，进一步拉低综合毛利率。

2024 年第一季度，发行人主营业务收入为 21,445.71 万元，同比上升 123.41%，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润同比上升 429.28%，主要原因系自 2023 年第三季度起，半导体行业重新步入上行周期，终端晶圆厂资本性开支复苏，发行人半导体领域新订单持续增加，产能利用率持续恢复。

如果未来发生市场竞争加剧、宏观经济景气度下行、国家产业政策变化、公司不能有效拓展国内外新客户、下游客户投资需求发生波动、研发投入未能及时实现产业转化及行业复苏不及预期等情形，公司将面临一定的经营压力，未来业绩存在大幅波动甚至出现亏损的风险。

3、市场竞争加剧导致产品价格和盈利能力下降风险

随着全球半导体行业的快速发展，对于半导体设备零部件的需求不断增加，吸引越来越多的市场参与者积极开展相关领域的投资，抢夺市场份额，同时行业内领先的企业通过并购重组进一步整合资源，使得市场竞争更加激烈。目前，半导体设备精密零部件市场主要由美国、日本和中国台湾地区的企业占据主导地位，公司与国际领先企业之间在市场竞争力、市场占有率上仍然存在一定的差距。同时，随着半导体领域国产替代进程的不断加速，未来可能将有更多国产零部件厂商加入市场竞争。如果公司未来无法通过提升研发实力、产品性能和客户拓展能力有效应对日益激烈的市场竞争，将导致公司产品的市场竞争力及产品价格下降，从而对公司的盈利能力产生不利影响。

4、市场空间及新业务拓展风险

由于半导体设备精密零部件种类繁多复杂，制作工艺差异巨大，因此即使是全球行业领先的头部企业，也只能专注于个别类型生产工艺，行业相对分散。发行人自设立时起即从事半导体设备精密零部件的研发、生产和销售，主要产品原材料以铝、不锈钢等金属为主，为金属类精密零部件，暂未涉及陶瓷件、石英件、硅/碳化硅件等其他半导体设备精密零部件，其他材质的半导体设备精密零部件

不属于发行人的目标市场。

报告期内，发行人产品除主要应用于半导体设备外，还将半导体设备领域零部件生产制造技术和经验进一步推广至光伏等泛半导体设备领域及医疗领域，并已经实现批量生产和销售，但在光伏、医疗领域进入时间较短、生产工艺尚未完全成熟、新产品开发成本较高。

因此，如未来半导体设备金属精密零部件市场空间被其他材质精密零部件替代，则发行人市场空间将下降；此外，如未来新业务相关产品毛利率不能尽快改善或新业务产品收入占比提升，也将拉低发行人综合毛利率，进而对发行人盈利能力产生不利影响。

5、客户集中度较高的风险

报告期内，公司向前五大客户的销售收入合计分别为 35,318.92 万元、38,471.38 万元、42,087.00 万元和 18,358.93 万元，占同期营业收入的比例分别为 83.37%、81.90%、75.46%和 84.81%，客户集中度较高且较为稳定，主要原因为半导体行业技术和资本高度密集，导致下游设备企业、晶圆代工企业呈现数量少、规模大的特征。若公司主要客户生产经营情况恶化、或由于半导体行业景气度下降导致客户资本性支出下降，进而导致其向公司下达的订单数量下降，则可能对公司的业绩稳定性产生影响。此外，如果公司无法维护与现有主要客户的合作关系与合作规模、无法有效开拓新客户资源并转化为收入，亦将可能对公司经营业绩产生不利影响。

6、半导体领域产品种类相对集中的风险

报告期内，公司半导体领域产品主要以各类精密金属零部件为主，相较于同行业可比公司暂不涉及气体管路，模组产品收入规模也较小。虽然公司在大陆刻蚀设备和薄膜沉积设备的同类型零部件产品的市场占有率与同行业可比公司基本一致，但由于公司产品种类相对集中，因此在整体经营规模、产品种类、应用领域等方面与行业龙头企业仍有一定差距。

7、存货余额及存货跌价准备上升、存货周转率波动的风险

公司存货主要由原材料、在制品、库存商品、委托加工物资和发出商品组成，报告期各期末，账面价值分别为 11,598.98 万元、17,255.57 万元、17,664.22

万元和 21,008.71 万元，占总资产的比例分别为 13.43%、18.98%、16.50%和 18.21%，报告期各期末，公司存货跌价准备金额分别为 1,051.22 万元、1,932.65 万元、2,089.15 万元和 1,988.04 万元。报告期各期，公司存货周转率分别为 2.89、1.79、2.01、0.64，呈先降后升趋势。

2022 年，半导体行业市场需求放缓，客户订单数量出现波动，且部分客户的交期有所延长，公司期末存货余额进一步上升；2023 年度，一方面，客户延期交付的产品陆续实现销售，库存商品余额有所下降；另一方面，为应对自 2023 年下半年起的行业周期性复苏需求，公司同步增加备货；2024 年第一季度，行业周期性复苏延续，公司收入和订单规模快速增加，委托加工物资、在制品和发出商品金额相应增加。

报告期内，公司根据存货的可变现净值低于成本的金额计提相应的存货跌价准备。若公司未来无法及时地预计市场需求的变动，或生产管理不当导致产品滞销、原材料积压等情形，则可能对公司营运资金周转造成不利影响，若半导体市场增速进一步放缓，原材料价格大幅下跌或市场竞争格局出现重大不利变化，则可能导致存货跌价准备迅速上升的风险，对公司经营业绩产生不利影响。

8、应收账款余额增加、经营活动现金流量净额及应收账款周转率波动的风险

报告期各期末，公司应收账款账面余额分别为 17,417.43 万元、15,138.09 万元、23,868.59 万元、31,639.71 万元，整体呈上升趋势；应收账款周转率分别为 3.11、2.89、2.86、0.78，呈先降后升趋势。

报告期内，发行人经营活动产生的现金流量净额分别为 1,246.17 万元、5,430.41 万元、13,607.40 万元和 1,097.08 万元。

公司客户主要为国内半导体设备龙头厂商，商业信用良好，但未来若主要客户因经营情况或商业信用发生重大不利变化，以及公司对信用风险管控不当，则可能导致应收账款不能及时收回，从而影响公司流动资金的周转和经营业绩。此外，公司近年来业务规模不断扩大，对于营运资金的需求持续增加。若未来公司无法通过股权融资、债务融资等方式合理筹措资金及规划资金使用计划，则公司在营运资金周转方面将会存在一定的风险。

二、申请上市股票的发行情况

(一) 本次发行的基本情况			
股票种类	人民币普通股 (A 股)		
每股面值	1.00 元		
发行股数	本次发行数量不超过 5,059.50 万股, 占发行后总股本的比例不低于 25%	占发行后总股本比例	不低于 25.00%
其中: 发行新股数量	不超过 5,059.50 万股	占发行后总股本比例	不低于 25.00%
股东公开发售股份数量	不适用	占发行后总股本比例	不适用
发行后总股本	不超过 20,237.99 万股		
每股发行价格	【】 元		
发行市盈率	【】 倍 (按扣除非经常性损益前后净利润的孰低额和发行后总股本全面摊薄计算)		
发行前每股净资产	【】 元	发行前每股收益	【】 元
发行后每股净资产	【】 元	发行后每股收益	【】 元
发行市净率	【】 倍 (按每股发行价格除以发行后每股净资产计算)		
发行方式	本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式		
发行对象	符合资格的参与战略配售的投资者、询价对象以及已开立上海证券交易所股票账户并开通科创板交易的境内自然人、法人等科创板市场投资者, 但法律、法规及上海证券交易所业务规则等禁止参与者除外		
承销方式	余额包销		
募集资金总额	【】 万元		
募集资金净额	【】 万元		
募集资金投资项目	靖江精密装配零部件制造基地扩容升级项目		
	无锡先研设备模组生产与装配基地项目		
	无锡先研精密制造技术研发中心项目		
	补充流动资金项目		
发行费用概算	本次发行费用总额为【】万元, 包括: 承销及保荐费【】万元、审计及验资费【】万元、评估费【】万元、律师费【】万元、发行手续费【】万元		
(二) 本次发行上市的重要日期			
刊登发行公告日期	【】 年【】 月【】 日		
开始询价推介日期	【】 年【】 月【】 日		

刊登定价公告日期	【】年【】月【】日
申购日期和缴款日期	【】年【】月【】日
股票上市日期	【】年【】月【】日

三、保荐人工作人员及其保荐业务执业情况

1、保荐代表人

本次具体负责推荐的保荐代表人为刘天宇和刘一为。其保荐业务执业情况如下：

刘天宇先生，作为保荐代表人参与了盟固利首次公开发行股票并在创业板上市项目，作为协办人参与了天孚通信非公开发行股票项目，作为项目组主要成员参与了昀冢科技首次公开发行股票并在科创板上市项目、英可瑞首次公开发行股票并在创业板上市项目、测绘股份向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市项目等。

刘一为先生，作为保荐代表人参与了世华科技首次公开发行股票并在科创板上市项目、测绘股份向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市项目，作为项目组主要成员参与了长光华芯首次公开发行股票并在科创板上市项目、翔楼新材首次公开发行股票并在创业板上市项目、梦百合首次公开发行股票并在主板上市项目、电工合金首次公开发行股票并在创业板上市项目、爱朋医疗首次公开发行股票并在创业板上市项目、林洋能源 2015 年及 2016 年非公开发行股票项目、天晟新材重大资产重组项目等。

2、项目协办人

本次先锋精科首次公开发行股票项目的原协办人为赵珈立，已离职。

3、其他项目组成员

其他参与本次先锋精科首次公开发行股票保荐工作的项目组成员还包括：吴学孔、朱辉、金鸣、李雨滋、章天欣、李文、刘德巍。

四、保荐人及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往来情况说明

华泰联合证券作为发行人的上市保荐人，截至本上市保荐书出具日：

（一）保荐人或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有或者通过参与本次发行战略配售持有发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况：

保荐人将安排依法设立的另类投资子公司或实际控制本保荐人的证券公司依法设立的另类投资子公司（以下简称“相关子公司”）参与本次发行战略配售，具体按照上海证券交易所相关规定执行。若相关子公司参与本次发行战略配售，相关子公司不参与询价过程并接受询价的最终结果，因此上述事项对本保荐人及保荐代表人公正履行保荐职责不存在影响。

除此之外，保荐人或其控股股东、实际控制人、重要关联方不存在持有发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况。

（二）发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方不存在持有保荐人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况。

（三）保荐人的保荐代表人及其配偶，董事、监事、高级管理人员，不存在持有发行人或其控股股东、实际控制人及重要关联方股份，以及在发行人或其控股股东、实际控制人及重要关联方任职的情况；

（四）保荐人的控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人控股股东、实际控制人、重要关联方不存在相互提供担保或者融资等情况；

（五）保荐人与发行人之间不存在其他关联关系。

五、保荐人承诺事项

（一）保荐人承诺已按照法律法规和中国证监会及上海证券交易所的相关规定，对发行人及其控股股东、实际控制人进行了尽职调查、审慎核查，充分了解发行人经营状况及其面临的风险和问题，履行了相应的内部审核程序。

（二）保荐人同意推荐江苏先锋精密科技股份有限公司在上海证券交易所科创板上市，相关结论具备相应的保荐工作底稿支持。

(三) 保荐人承诺, 将遵守法律、行政法规和中国证监会、上海证券交易所对推荐证券上市的规定, 接受上海证券交易所的自律管理。

六、保荐人关于发行人是否已就本次证券发行上市履行了《公司法》《证券法》和中国证监会及上海证券交易所规定的决策程序的说明

发行人就本次证券发行履行的内部决策程序如下:

1、2023年3月23日, 发行人召开了第一届董事会第四次会议, 该次会议应到董事7名, 实际出席本次会议7名, 审议通过了《关于公司首次公开发行股票并上市方案的议案》等议案。

2、2023年4月7日, 发行人召开了2023年第一次临时股东大会, 出席会议股东代表持股总数15,178.4856万股, 占发行人股本总额的100.00%, 审议通过了《关于公司首次公开发行股票并上市方案的议案》等议案。

依据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票注册管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及发行人《公司章程》的规定, 发行人申请在境内首次公开发行股票并在科创板上市已履行了完备的内部决策程序。

七、保荐机构针对发行人是否符合板块定位及国家产业政策的依据及核查情况

(一) 发行人符合科创板定位

1、发行人技术先进性、模式创新性、研发技术产业化情况及未来发展战略

(1) 技术先进性

1) 长期专注于刻蚀和薄膜沉积设备核心精密零部件制造

刻蚀设备、薄膜沉积设备是半导体晶圆前道生产的重要设备, 其制造技术难度仅次于光刻设备。

在刻蚀设备方面, 以等离子体刻蚀设备为例, 该设备是在芯片上进行微观雕刻工序, 仅以刻孔为例, 其直径是头发丝的几千分之一, 加工精度、均匀性、重

复性要达到数万分之一，每台刻蚀设备每年需刻蚀百万万亿个既细又深的接触孔或者线条，工作量巨大的同时还要求合格率达到 **99.99%** 以上。因此，刻蚀设备对腔体、内衬等核心零部件的耐腐蚀性、洁净度、致密性等均有严苛要求。

在薄膜沉积设备方面，其工艺是通过在反应室内的物理化学作用，使介质在晶圆上沉积形成高性能、高致密性薄膜。由于极高的功能性和均匀性要求，作为关键工艺部件的匀气盘和加热器，在气体分配、混合、反应以及温度调节的控制中起着重要作用，因此对匀气盘、加热器等零部件的加工精准度、平面度、洁净度及温度场控制等方面都提出了极致的工艺要求。

公司自设立时起即确立了专注刻蚀设备、薄膜沉积设备等半导体核心设备中的核心零部件的“双核”产品路线。经过长期的技术攻关和经验积累，公司不断根据客户反馈进行更新迭代，使工艺和产品不断完善，围绕客户产品标准形成了较强的研发能力、技术能力及产业化能力。

公司现已在精密机械制造技术、表面处理技术、焊接技术三大重点技术领域形成了丰富的工程技术能力，在高端器件领域形成了自主设计和开发技术，同时发展了定制化工装开发及应用能力，以适应产品多样化及研发快速响应的要求。

2) 持续投入技术研发提升科技创新能力

公司通过与主要客户多年的合作开发，经历了国内半导体装备从无到有、从初级到先进制程的发展历程，建立了与国内龙头半导体设备厂商需求高度契合的科技创新能力。

公司始终将科技创新作为自身发展的核心驱动力，持续投入技术研发攻克工艺难关。报告期内，公司研发费用分别为 **2,154.10** 万元、**3,097.44** 万元、**3,630.90** 万元和 **1,198.95** 万元，逐年上升。截至本上市保荐书签署日，公司已形成 **31** 项发明专利及 **69** 项实用新型专利。

作为国内龙头设备厂商的核心金属精密零部件供应商，公司长期配合客户开发、试样、定型新零件，有力支持了国内刻蚀设备和薄膜沉积设备的创新发展，报告期内，公司累计导入逾 **11,000** 种新零部件开发，逐年增加，在多种关键工艺零部件上实现国产化突破。

通过持续的技术研发投入，在国产 **CCP** 高容性高能等离子体刻蚀领域，公

司批量生产的腔体已规模化应用在国际最先进的 7nm 及以下芯片刻蚀设备；在国产主流等离子 LED 芯片刻蚀领域，公司是该类设备反应腔室套件的核心供应商；在氮化镓基 LED MOCVD 领域及 12 寸 PECVD 领域，公司是该类设备关键工艺部件——匀气盘的核心供应商。此外，公司通过高端器件的设计及开发技术实现了金属加热器的自主创新突破。

（2）模式创新性

1) 柔性化精益制造模式

经过多年的生产探索，公司针对产品多品种、小批量、定制化的特点，形成了一套适合自身的柔性化精益制造体系。该体系的建立使得公司成为半导体设备精密零部件的生产制造整合平台，能够以较高的效率、具有竞争力的价格向客户交付最终产品。

在内部管理上，公司通过管理每日有效产出取得平稳的生产工序流动，从而缩短制造周期和避免逾期交付。通过对生产车间主要工序的节点管理，公司可以分解制造过程中的相关联要素而不受各制造中心复杂细节的干扰。针对定制化、多品种、小批量的生产方式，公司创造性地设计和应用多层级动态计划排产模式，从预排产、主计划、车间日排产、资源和资源组报告等精细化管理实现优先级别的计划执行动态切换；其次，公司利用数字化技术、协同及集成定制化智能管理软件，能够实时跟踪和监控各类产品的生产制造流程，确保种类繁多的产品能够实现有序生产和前道工序的实时可追溯，也实现了工艺流程、现场管理的优化调整与持续改进。

在外部管理上，公司针对半导体精密零部件制造难度大、工艺步骤较多且不同细分工艺领域专业度高的特点，建立了一个以精密零部件为载体，多工艺联合迭代制造的生态系统，产业链各主体努力在各自专业领域取得突破。通过该种生态模式，公司不仅能平滑产能瓶颈和短期订单需求高峰，还能将内外部多种先进工艺完整集成在最终产品制造上，从而实现柔性化精益制造。

2) 与客户长期协同迭代的开发机制

快速迭代发展是半导体设备及零部件进步的重要特征，公司自设立时起即立下陪伴国产本土半导体设备厂商共同发展的愿景，与国产主流半导体设备厂商建

立了长期稳定的协同迭代开发机制。以刻蚀设备为例，公司作为反应腔室的核心供应商，深度参与客户核心设备型号关键精密零部件的研发，助力客户设备的不断更新迭代。在此过程中，对于产品在客户设备研发和应用中发现的问题，公司通过与客户全面、多层次沟通，得以改善和精进自身工艺并最终沉淀到公司的生产制程、产品设计中，形成公司的核心竞争力，确保公司产品能够始终匹配或超越客户标准。通过上述协同迭代开发机制，公司能够始终保持竞争优势，成为半导体设备核心零部件国产化的引领者。

3) 精密零部件完整制造体系

目前，我国半导体设备零部件行业集中度较低，资本投入和技术壁垒相对较高，与下游的设备企业往往只从事一或两道工序情况相似，行业内大多数企业只专注于个别工艺技术，或特定零部件产品，无法形成完整工序体系。公司是国内行业内少有的能够覆盖半导体设备精密零部件较为完整制造体系的企业之一，具备精密机械制造、表面处理、焊接及检测在内的全节点制造工艺和产能。公司通过一站式的制造解决方案，不仅能较好地控制产品品质和一致性，还能为客户节约采购成本。

(3) 研发技术产业化情况

公司的研发实力是其核心竞争力的重要来源。公司从设立之初就十分重视研发，在精密机械制造技术、表面处理技术、焊接技术、高端器件的设计及开发技术和定制化工装开发技术等方面持续投入。近年来公司业务进入高速增长阶段，研发需求持续增长，报告期各期，公司研发费用分别为 2,154.10 万元、3,097.44 万元、3,630.90 万元和 1,198.95 万元，2021-2023 年复合增长率为 29.83%，研发投入力度不断加强。

公司取得的科研成果已经形成公司的核心技术并充分产业化，服务于下游客户半导体设备生产制造。目前，公司产品已经批量应用于国内头部半导体设备制造商，并成为该等客户同类产品的重要供应商之一。例如，在中微公司批量生产的应用于 7nm 及以下制程芯片生产线的 CCP 刻蚀设备及其氮化镓基 LED MOCVD 设备领域，公司是关键工艺部件——腔体、匀气盘的核心供应商，在国内半导体刻蚀和薄膜沉积设备的核心金属零部件领域占据重要地位。

(4) 未来发展战略

1) 深耕半导体设备零部件市场，持续突破先进制程工艺

中国半导体产业在过往历史积累和发展过程中已经取得了长足进步，但在装备水平和数量上与发达国家仍存在较大差距，同时在关键装备自主可控的国家战略背景下，公司所处的零部件市场增长空间较大。因此，公司未来将继续坚持深耕半导体设备零部件市场，不断迭代完善五大技术平台，进一步提升现有核心产品竞争力，同时，在 7nm 及以下先进制程上持续取得技术和产品的突破。

2) 紧跟国产化替代进程，拓展关键器件领域，

半导体设备器件国产化已呈现出较为巨大的市场需求，公司在金属加热器上已取得多年技术积累，与行业龙头装备企业建立了紧密的合作关系，并实现多款产品量产。公司将继续深化基础材料的研发和应用，提升工艺装备水平，将产品从加热器向其它关键器件进行拓展，进一步丰富产品的形态和应用场景，提高关键器件的国产化水平，增强公司核心竞争力。

3) 依托现有技术和产业化能力，拓展其他精密制造领域

国内先进装备行业的快速发展，对精密制造技术及能力提出了更高需求，公司基于所具备的五大技术平台、产业化及精益生产管理能力和在现有产品种类的基础上，将进一步向医疗、光伏及模组产品等其他精密制造领域拓展，为公司未来发展创造更大空间和新的利润增长点。

公司是国内半导体设备零部件主要制造商，未来将进一步在现有产品专精的特点上，牢牢把握国产化浪潮机会，多层次、多应用领域拓展业务，通过不断精进和完善工艺技术，实现高质量发展。

2、发行人符合科创板行业领域要求

根据《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定（2024 年 4 月修订）》，公司属于“第五条之（二）高端装备领域，主要包括智能制造、航空航天、先进轨道交通、海洋工程装备及相关服务等”列示的科技创新企业。

公司所属行业领域	<input type="checkbox"/> 新一代信息技术	根据《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》，公司所属行业领
	<input checked="" type="checkbox"/> 高端装备	

	<input type="checkbox"/> 新材料	域属于“通用设备制造业”（代码：C34）下的“机械零部件加工”（代码：C3484）；根据国家统计局颁布的《战略性新兴产业分类（2018）》，公司所属行业领域属于“2 高端装备制造产业”之“2.1 智能制造装备产业”之“2.1.5 智能关键基础零部件制造”
	<input type="checkbox"/> 新能源	
	<input type="checkbox"/> 节能环保	
	<input type="checkbox"/> 生物医药	
	<input type="checkbox"/> 符合科创板定位的其他领域	

3、发行人符合科创属性相关指标要求

根据《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定（2024 年 4 月修订）》及《科创属性评价指引（试行）》，公司科创属性的符合情况如下：

科创属性评价标准	是否符合	指标情况
最近三年研发投入占营业收入比例≥5%，或最近三年研发投入金额累计≥8,000 万元	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	2021 年至 2023 年，公司研发投入占营业收入比例为 6.12%，超过 5%；金额累计为 8,882.44 万元，超过 8,000 万元
研发人员占当年员工总数的比例不低于 10%	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	截至 2023 年 12 月 31 日，公司共拥有 710 名员工，其中研发人员 106 名，占比 14.93%，超过 10%
应用于公司主营业务并能够产业化的发明专利≥7 项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	截至 2024 年 3 月 31 日，公司拥有 29 项发明专利，均被应用于公司主营业务并能够产业化，超过 7 项
最近三年营业收入复合增长率≥25%，或最近一年营业收入金额≥3 亿	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	2023 年，公司营业收入为 55,771.69 万元，超过 3 亿元

（二）发行人符合国家产业政策

根据国家统计局颁布的《战略性新兴产业分类（2018）》，公司所属行业领域属于“2 高端装备制造产业”之“2.1 智能制造装备产业”之“2.1.5 智能关键基础零部件制造”。公司主营产品为半导体刻蚀和薄膜沉积设备细分领域关键零部件，是当前国家产业政策大力支持的半导体产业链中的核心环节之一。因此，发行人符合国家产业政策。

（三）核查情况

1、核查方法

（1）核查发行人主营业务、主要产品、业务模式、所处行业、上下游行业情况等，对发行人所处行业进行专业判断；

（2）访谈发行人董事、高级管理人员、外部顾问等，了解发行人承担社会

责任情况及发行人未来发展规划；

(3) 实地核查发行人生产设施及经营场所，结合发行人掌握的经营模式、研发水平、人才储备，对发行人及产品是否面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求，是否主要服务于符合国家战略、突破关键核心技术，是否属于市场认可度高的科技创新企业，是否属于重点支持的高新技术产业和战略性新兴产业等进行核查分析；

(4) 取得发行人研发项目情况，核查发行人研究能力与技术能力情况；

(5) 对发行人营业收入和研发费用金额及相关比例、研发人员和发明专利数量、发明专利与主营业务的关系进行核查；

(6) 查阅相关行业研究报告、政策法规，对发行人下游市场前景情况进行分析论证。

2、核查结论

经核查，发行人主营业务符合国家战略，具有技术先进性和模式创新性，科技创新能力突出，符合科创板定位及国家产业政策。

八、保荐人关于发行人是否符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的上市条件的说明

(一) 符合《证券法》、中国证监会规定的发行条件

1、本次证券发行符合《证券法》规定的发行条件的说明

华泰联合证券依据《证券法》第十二条关于首次公开发行新股的条件，对发行人的情况进行逐项核查，并确认：

(1) 发行人具备健全且运行良好的组织机构；

经履行获取发行人内部组织结构图，查阅发行人相关管理制度和业务制度、访谈发行人相关人员等核查程序，本保荐人认为，发行人已经依法设立了股东大会、董事会和监事会，并建立了独立董事、董事会秘书制度，聘请了高级管理人员，设置了若干职能部门，发行人具备健全且良好的组织机构。

(2) 发行人具有持续经营能力；

经履行查阅会计师出具的审计报告、查阅行业政策和研究报告、访谈发行人相关人员和主要客户、获取并核查发行人取得的订单及意向订单等核查程序，本保荐人认为，发行人具有持续经营能力。

(3) 发行人最近三年财务会计报告被出具无保留意见审计报告；

经履行查阅会计师出具的审计报告、抽查相关重点科目的会计凭证等核查程序，本保荐人认为，发行人最近三年的财务报告被出具无保留意见审计报告。

(4) 发行人及其控股股东、实际控制人最近三年不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪；

经获取相关政府部门出具的合规证明、访谈相关政府部门及发行人相关人员，同时结合网络搜索核查程序，本保荐人认为，发行人及其控股股东、实际控制人最近三年不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪。

(5) 经国务院批准的国务院证券监督管理机构规定的其他条件。

经履行查阅国务院证券监督管理机构关于企业公开发行证券的相关规定等核查程序，本保荐人认为，发行人符合经国务院批准的国务院证券监督管理机构规定的其他条件。

综上，本保荐人认为，本次证券发行符合《证券法》规定的发行条件。

2、本次证券发行符合《首次公开发行股票注册管理办法》规定的发行条件的说明

(1) 发行人是依法设立且持续经营三年以上的股份有限公司，具备健全且运行良好的组织机构，相关机构和人员能够依法履行职责。有限责任公司按原账面净资产值折股整体变更为股份有限公司的，持续经营时间可以从有限责任公司成立之日起计算。

查证过程及事实依据如下：

保荐人通过查阅发行人设立时的营业执照、公司章程、发起人协议、股东大会文件、评估报告、审计报告、验资报告、工商登记文件等资料，核查了发行人

的设立程序、工商注册登记的合法性、真实性。根据上述资料，发行人系靖江先锋半导体科技有限公司于 2022 年 11 月整体变更设立的股份有限公司，发行人的设立已履行了必要批准、审计、评估、验资、工商登记等程序。

同时，保荐人查阅了发行人历年营业执照、公司章程、工商登记等文件，以及历年业务经营情况记录、年度财务报告等资料。根据上述资料，发行人持续经营时间从有限公司成立之日起计算，持续经营已逾三年，具备健全且运行良好的组织机构，相关机构和人员能够依法履行职责。

(2) 发行人会计基础工作规范，财务报表的编制和披露符合企业会计准则和相关信息披露规则的规定，在所有重大方面公允地反映了发行人的财务状况、经营成果和现金流量，最近三年财务会计报告由注册会计师出具无保留意见的审计报告。发行人内部控制制度健全且被有效执行，能够合理保证公司运行效率、合法合规和财务报告的可靠性，并由注册会计师出具无保留结论的内部控制鉴证报告。

查证过程及事实依据如下：

保荐人查阅了发行人会计政策、财务核算及财务管理制度，查阅了发行人会计账簿与会计报表，抽查了发行人会计凭证，核查了发行人各项内部控制制度的建立以及执行情况，并访谈了相关财务人员，取得了立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《审计报告》（信会师报字[2024]第 ZA13463 号）和《内部控制鉴证报告》（信会师报字[2024]第 ZA13466 号）。

经核查，发行人会计基础工作规范，财务报表的编制和披露符合企业会计准则和相关信息披露规则的规定，在所有重大方面公允地反映了发行人的财务状况、经营成果和现金流量，并由注册会计师出具标准无保留意见的审计报告，发行人内部控制制度健全且被有效执行，能够合理保证发行人运行效率、合法合规和财务报告的可靠性，并由注册会计师出具无保留结论的内部控制鉴证报告。

(3) 发行人业务完整，具有直接面向市场独立持续经营的能力。

①资产完整，业务及人员、财务、机构独立，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在对发行人构成重大不利影响的同业竞争，不存在严重影响独立性或者显失公平的关联交易；

查证过程及事实依据如下：

保荐人核查了发行人主要资产、专利、商标的权属情况、各机构的人员设置以及实际经营情况；对控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的基本情况进行了核查；同时对发行人关联交易程序的合规性、定价的公允性、发生的合理性等进行了核查。

经核查，发行人资产完整，业务及人员、财务、机构独立，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在对发行人构成重大不利影响的同业竞争，不存在严重影响独立性或者显失公平的关联交易。

②主营业务、控制权和管理团队稳定，最近二年内主营业务和董事、高级管理人员及核心技术人员均没有发生重大不利变化。

发行人的股份权属清晰，不存在导致控制权可能变更的重大权属纠纷，最近二年实际控制人没有发生变更；

查证过程及事实依据如下：

保荐人查阅了发行人及其重要子公司《企业法人营业执照》《公司章程》以及工商登记档案相关资料，并访谈了发行人实际控制人、业务负责人。经核查，发行人最近 2 年内主营业务一直为半导体设备精密零部件产品的研发、生产和销售，没有发生重大不利变化。同时，保荐人查阅了发行人工商登记档案资料、《公司章程》以及发行人股东大会决议、董事会决议、员工花名册及相关人员简历，经核查，发行人最近 2 年董事、高级管理人员、核心技术人员没有发生重大不利变化。综上，发行人主营业务、控制权和管理团队稳定。

并且，保荐人查阅了发行人工商登记档案资料以及发行人股东大会、董事会记录，并访谈了发行人实际控制人游利。经核查，发行人最近 2 年实际控制人没有发生变更，控股股东和受控股股东、实际控制人支配的股东所持发行人的股份权属清晰，不存在导致控制权可能变更的重大权属纠纷。

③发行人不存在主要资产、核心技术、商标等的重大权属纠纷，重大偿债风险，重大担保、诉讼、仲裁等或有事项，经营环境已经或者将要发生重大变化等对持续经营有重大不利影响的事项。

查证过程及事实依据如下：

保荐人核查了发行人主要资产、专利、商标的权属情况，对主要核心技术人员进行了访谈；核查了发行人的征信报告并函证了主要银行；结合网络查询以及对当事人的访谈，核查是否存在诉讼、仲裁等或有事项；研究了发行人所处行业的发展情况。

经核查，发行人不存在主要资产、核心技术、商标等的重大权属纠纷，重大偿债风险，重大担保、诉讼、仲裁等或有事项，经营环境已经或者将要发生重大变化等对持续经营有重大不利影响的事项。

(4) 发行人生产经营符合法律、行政法规的规定，符合国家产业政策。

最近三年内，发行人及其控股股东、实际控制人不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，不存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为。

董事、监事和高级管理人员不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚，或者因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正在被中国证监会立案调查且尚未有明确结论意见等情形。

查证过程及事实依据如下：

保荐人查阅了所属行业相关法律法规和国家产业政策，访谈了发行人高级管理人员，查阅了发行人生产经营所需的各项权利证书等，实地查看了发行人生产经营场所，同时，结合网络查询等手段，核查了发行人及其控股股东、实际控制人是否存在刑事犯罪或重大违法情况，董事、监事和高级管理人员是否存在被处罚的情况。

经核查，发行人生产经营符合法律、行政法规的规定，符合国家产业政策。最近 3 年内，发行人及其控股股东、实际控制人不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，不存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为。发行人的董事、监事和高级管理人员不存在最近 3 年内受到中国证监会行政处罚，或者因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或者涉

嫌疑违法违规正在被中国证监会立案调查且尚未有明确结论意见等情形。

（二）发行后股本总额不低于 3,000 万元

截至本上市保荐书出具日，发行人注册资本为 15,178.49 万元，发行后股本总额不低于 3,000 万元。综上，保荐人认为，发行人符合上述规定。

（三）公开发行的股份达到公司股份总数的 25%以上；公司股本总额超过 4 亿元的，公开发行股份的比例为 10%以上

本次公开发行后公司股本总额不超过 20,237.99 万股，股本总额未超过 4 亿元，公开发行股份的比例达到 25%以上。综上，保荐人认为，发行人符合上述规定。

（四）市值及财务指标符合《上市规则》规定的标准

发行人为境内企业且不存在表决权差异安排的，市值及财务指标应当至少符合下列标准中的一项：

1、预计市值不低于人民币 10 亿元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币 5,000 万元，或者预计市值不低于人民币 10 亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币 1 亿元；

2、预计市值不低于人民币 15 亿元，最近一年营业收入不低于人民币 2 亿元，且最近三年累计研发投入占最近三年累计营业收入的比例不低于 15%；

3、预计市值不低于人民币 20 亿元，最近一年营业收入不低于人民币 3 亿元，且最近三年经营活动产生的现金流量净额累计不低于人民币 1 亿元；

4、预计市值不低于人民币 30 亿元，且最近一年营业收入不低于人民币 3 亿元；

5、预计市值不低于人民币 40 亿元，主要业务或产品需经国家有关部门批准，市场空间大，目前已取得阶段性成果。医药行业企业需至少有一项核心产品获准开展二期临床试验，其他符合科创板定位的企业需具备明显的技术优势并满足相应条件。

查证过程及事实依据如下：

保荐人查阅了发行人营业执照、公司章程及工商登记等资料，发行人系境内企业且不存在表决权差异安排；查阅了申报会计师出具的审计报告，发行人 2022 年度、2023 年度归属于母公司所有者净利润分别为 9,895.25 万元和 7,978.54 万元（以扣除非经常性损益后孰低原则计算）；结合发行人历史上的股权融资估值情况、目前盈利水平以及同行业上市公司的市盈率等情况，对发行人的市值评估进行了分析。

经核查，发行人符合“预计市值不低于人民币 10 亿元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币 5,000 万元，或者预计市值不低于人民币 10 亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币 1 亿元”的标准。

九、保荐人关于发行人证券上市后持续督导工作的具体安排

持续督导事项	具体安排
1、督促上市公司建立和执行信息披露、规范运作、承诺履行、分红回报等制度	1、协助和督促上市公司建立相应的内部制度、决策程序及内控机制，以符合法律法规和上市规则的要求； 2、确保上市公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员、核心技术人员知晓其各项义务； 3、督促上市公司积极回报投资者，建立健全并有效执行符合公司发展阶段的现金分红和股份回购制度； 4、持续关注上市公司对信息披露、规范运作、承诺履行、分红回报等制度的执行情况。
2、识别并督促上市公司披露对公司持续经营能力、核心竞争力或者控制权稳定有重大不利影响的风险或者负面事项，并发表意见	1、持续关注上市公司运作，对上市公司及其业务充分了解； 2、关注主要原材料供应或者产品销售是否出现重大不利变化；关注核心技术人员稳定性；关注核心知识产权、特许经营权或者核心技术许可情况；关注主要产品研发进展；关注核心竞争力的保持情况及其他竞争者的竞争情况； 3、关注控股股东、实际控制人及其一致行动人所持上市公司股权被质押、冻结情况； 4、核实上市公司重大风险披露是否真实、准确、完整。
3、关注上市公司股票交易异常波动情况，督促上市公司按照上市规则规定履行核查、信息披露等义务	1、通过日常沟通、定期回访、调阅资料、列席股东大会等方式，关注上市公司日常经营和股票交易情况，有效识别并督促上市公司披露重大风险或者重大负面事项； 2、关注上市公司股票交易情况，若存在异常波动情况，督促上市公司按照交易所规定履行核查、信息披露等义务。
4、对上市公司存在的可能严重影响公司或者投资者合法权益的事项开展专项核查，并出具现场核查报告	1、上市公司出现下列情形之一的，自知道或者应当知道之日起 15 日内进行专项现场核查：（一）存在重大财务造假嫌疑；（二）控股股东、实际控制人、董事、监事或者高级管理人员涉嫌侵占上市公司利益；（三）可能存在重大违规担保；（四）资金往来或者现金流存在重大异常；（五）交易所或者保荐人认为应当进行现场核查的其他事项；

持续督导事项	具体安排
	2、就核查情况、提请上市公司及投资者关注的问题、本次现场核查结论等事项出具现场核查报告，并在现场核查结束后 15 个工作日内披露。
5、定期出具并披露持续督导跟踪报告	1、在上市公司年度报告、半年度报告披露之日起 15 个工作日内，披露持续督导跟踪报告； 2、上市公司未实现盈利、业绩由盈转亏、营业收入与上年同期相比下降 50%以上或者其他主要财务指标异常的，在持续督导跟踪报告显著位置就上市公司是否存在重大风险发表结论性意见。
6、持续督导期限	在本次发行结束当年的剩余时间以及以后 3 个完整会计年度内对发行人进行持续督导

十、其他说明事项

无。

十一、保荐人对发行人本次股票上市的保荐结论

保荐人华泰联合证券认为江苏先锋精密科技股份有限公司申请其股票上市符合《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《首次公开发行股票注册管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则》等法律、法规的有关规定，发行人股票具备在上海证券交易所上市的条件。华泰联合证券愿意保荐发行人的股票上市交易，并承担相关保荐责任。

（以下无正文）

(本页无正文,为《华泰联合证券有限责任公司关于江苏先锋精密科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之上市保荐书》之签章页)

项目协办人: _____

保荐代表人: 刘天宇
刘天宇

刘一为
刘一为

内核负责人: 邵年
邵年

保荐业务负责人: 唐松华
唐松华

法定代表人
(或授权代表): 江禹
江禹

保荐人:

华泰联合证券有限责任公司
2024年8月20日

